



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

注記
1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コネクタ: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金

2. めっき: コネクタ: 全面Ni下地
接触部: 0.38µm MIN金めっき

3. めっき: コネクタ: 全面Ni下地
接触部: 0.76µm MIN金めっき

4. めっき: コネクタ: 全面Ni下地
接触部: 2.0 µm MINスズめっき

5. めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき

6. めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部
ニッケル下地の上にスズめっき

NOTES
1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO
PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY

2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38µm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING

3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76µm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING

4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 µm MIN TIN
PLATED OVER NICKEL

5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

△6	△4	178326-5
△6	△3	178326-3
△6	△2	178326-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

Copyright © 1995 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mm (AWG)		mm		12 POS DOUBLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100	
MATERIAL		FINISH		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
SEE NOTE 注記参照		SEE NOTE 注記参照		SIZE LOC NUMBER	
DR. 23 JUN 95 N. Matsubara		DE. 23 JUN 95 N. Matsubara		A3 J C-178326	
CHK. 30 JUN 95 Y. ISHIKAWA		APP. 3 JUL 95 S. MANABE		SCALE REV. SHEET	
LTR REVISION RECORD		DR CHK DATE		2-1 B 1 of 1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[178326-2](#)